

2009-2010年中国半导体材料行业市场调研与投资 分析

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2009-2010年中国半导体材料行业市场调研与投资分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/3635136351.html>

报告价格：电子版: 6000元 纸介版：6000元 电子和纸介版: 6000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

目录

第一章 半导体材料概述

第一节 半导体材料定义

第二节 半导体材料分类

第三节 化合物半导体材料介绍

第四节 半导体材料特性和参数

第五节 半导体材料制备

第六节 半导体材料技术动向及挑战

第二章 2008-2009年世界半导体材料市场分析

第一节 世界总体市场概况

一、2008年全球半导体材料市场分析

二、全球半导体材料的进展

三、全球半导体材料市场现状调查

四、第二代半导体材料砷化镓发展概况

五、第三代半导体材料GaN发展概况

第二节 北美半导体材料发展分析

一、北美半导体设备与材料市场

二、美国半导体材料市场发展现状及预测

三、普林斯顿大学用原子移栽手段获得磁性半导体材料

四、美国利用氧化锌和钴混合物开发新半导体材料

五、美国速干型环氧新材料大降半导体成本

六、美科学家科技发现新型碳晶体管胜过非晶硅

七、道康宁在半导体材料方面的研究进展

八、SAFCHitech公布硅半导体基片技术

九、霍尼韦尔研究解决半导体热管理难题

十、杜邦在台湾成立半导体材料技术中心

十一、IBM和JSR合作研发新型材料推进半导体制造技术

第三节 亚洲半导体材料发展

一、日本半导体材料巨头增加投资以提高产能

二、日本开发出有机半导体新材料

三、瑞萨科技发布硅锗功率晶体管

四、韩国积极扶持半导体及原材料产业

五、台湾地区成为全球第二大半导体材料市场

第四节 欧洲半导体材料市场发展情况

- 一、英国推出应用于半导体领域的PEEK材料
- 二、德国科学家利用硅材料研制发光器件
- 三、适合于CMOS的有机半导体材料开发情况

第五节 世界半导体材料发展趋势

- 一、半导体材料市场加速转移之势
- 二、32nm以下IC半导体性能提升靠材料技术的新突破

第三章 2008-2009年中国半导体材料行业分析

第一节 行业发展概况

- 一、国内半导体材料发展情况
- 二、我国IC支撑材料瓶颈待突破
- 三、政策支持力度有待加强
- 四、中国半导体设备与材料市场概览
- 五、发展我国半导体材料的建议

第二节 技术开发及应用

- 一、我国半导体材料研究进展
- 二、湖南高精度数控多线切割机床打破国外技术垄断
- 三、半导体材料竞争无线应用领域
- 四、SOI技术瓶颈突破
- 五、有机半导体材料的设计、合成和场效应晶体管研究获新进展

第三节 半导体封装材料行业分析

- 一、电子材料市场
- 二、电子材料供应商
- 三、半导体封装材料市场
- 四、半导体封装业市场
- 五、半导体封装材料的进展

第四节 2008-2009年中国半导体材料进出口状况

- 一、2008-2009年进出口总量统计
- 二、2008-2009年半导体材料进口统计
- 三、2008-2009年半导体材料出口统计

第五节 金融危机下半导体设备材料供应商应对措施

- 一、加强研发为产业复兴做好准备
- 二、晶圆涂层新技术降低封装成本
- 三、石墨原料、提纯及部件加工形成完整价值链
- 四、本地技术支持能力非常重要

五、大批量产品测量系统支持低成本制造

六、加大光伏和LED市场投资力度

七、与本地供应商合作改善材料质量降低成本

第四章 2008-2009年主要半导体材料发展分析

第一节 硅晶体

一、国内多晶硅产业概况

二、我国在建多晶硅项目总投资分析

三、中国多晶硅企业遭遇挑战

四、未来多晶硅行业发展的趋势分析

五、2009年多晶硅现货价格分析

六、2009年全球多晶硅供需分析

七、金融危机下 中国多晶硅项目大盘点

第二节 砷化镓

一、2010年前砷化镓设备的防务市场将持续走强

二、2013年后在雷达系统制造中砷化镓将被硅锗取代

三、ANADIGICS昆山投建6英寸砷化镓晶圆制造厂

四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产

五、砷化镓聚光太阳能电池的规模生产

六、4英寸砷化镓化合物半导体芯片生产线落户南京

七、砷化镓产业发展情况

第三节 GaN

一、半导体材料GaN产业现状

二、GaN产业市场投资前景

三、GaN复合年增率分析

四、2010年中国GaN类LED产量将居全球第二

第四节 碳化硅

一、SiC概况

二、碳化硅市场分析

三、碳化硅在LED产业发展中的应用

四、中国SiC项目公司简介

五、2009年兵团将建成全国最大的碳化硅晶体生产基地

六、2009年天津特办第一季度碳化硅出口分析

七、2009年大连特办碳化硅出口分析

八、天富热电积极开拓碳化硅市场

九、南京鑫启硅业新建碳化硅生产线正式投产

十、国内碳化硅晶体发展情况

十一、碳化硅将领航新型功率半导体器件材料

第五节 其他半导体材料

一、非晶半导体材料介绍

二、锗金属需求旺盛价格坚挺

三、用磷化铟等材料制成的半导体光子集成芯片

第五章 2008-2009年半导体行业发展分析

第一节 2008-2009年国内外半导体产业发展情况

一、国内外半导体产业简况

二、2008年半导体厂商竞争力分析

三、2008年半导体市场评述

四、2009年中国半导体市场发展预测

五、光伏半导体设备市场旺销

六、中国内地半导体产业的“生态”环境

第二节 中国半导体市场发展形势及预测

一、国内外半导体市场形势分析

二、2008全球半导体市场发展及2009年预测

三、2009年全球半导体产业发展分析预测

四、Gartner修改2009年半导体行业设备投资预测

五、深圳市打造全球最大化合物半导体基地

第六章 2008-2009年主要半导体市场分析

第一节 LED产业发展

一、全球LED产业发展

二、全球LED专利布局

三、LED技术发展

四、LED应用市场

五、中国LED产业发展与前景

第二节 电子元器件市场

一、全球电子元器件行业需求回暖

二、中国电子元件产量占全球四成

三、金融危机对电子元件的影响分析

四、2008年电子元器件业主要经济指标

五、2009年中国电子元器件分销商分析

第三节 集成电路

一、2008中国集成电路产业市场分析

- 二、中国集成电路业面临四大瓶颈
- 三、国内外集成电路技术发展现状及差距
- 四、中国集成电路产业未来发展机遇
- 五、2008-2009年半导体集成电路产品产量

第四节 半导体分立器件

- 一、中国半导体分立器件市场发展概况
- 二、2008大陆半导体分立器件应用规模
- 三、中国大陆半导体分立器件主要靠进口
- 四、半导体分立器件未来的发展趋势
- 五、2008-2009年半导体分立器件产量

第五节 其他半导体市场

- 一、半导体气体与化学品产业发展趋势
- 二、IC光罩市场概况分析
- 三、2008年掩膜市场发展情况

第七章 半导体材料主要生产商

第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、财务分析
- 三、经营状况
- 四、发展前景

第二节 天津中环半导体股份有限公司

- 一、公司概况
- 二、业务发展情况
- 三、经营状况
- 四、财务分析

第三节 峨嵋半导体材料厂

- 一、企业概况
- 二、经营状况
- 三、发展前景

第四节 四川新光硅业科技有限责任公司

- 一、公司概况
- 二、所处行业与地位
- 三、财务分析

第五节 洛阳中硅高科技有限公司

- 一、企业概况

二、技术研发

第六节 宁波立立电子股份有限公司

一、公司概况

二、产品介绍

三、发展战略

第七节 宁波康强电子股份有限公司

一、公司概况

二、经营情况

四、财务分析

第八节 南京国盛电子有限公司

一、公司简介

二、工艺技术与产品

第九节 中科镓英半导体有限公司

一、公司简介

二、发展情况

第八章 半导体材料的发展趋势与前景预测

第一节 半导体产业的前景分析

一、我国半导体产业前景光明

二、2010年我国大陆将占世界半导体市场1/3

三、半导体设备业前景分析

四、半导体技术发展的低耗能趋势

第二节 半导体材料产业的发展趋势分析

一、2010年全球半导体材料市场预测

二、2011年世界半导体材料市场规模预测

三、半导体材料的发展趋势

四、2010年化合物半导体材料市场预测

五、半导体清模材料的发展趋势

六、利用半导体材料开发新能源的前景

部分图表目录

图表：2009年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进出口总量统计

图表：2009年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进口分省份统计

图表：2009年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等出口分省份统计

图表：2009年半导体集成电路产品产量全国合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量北京市合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量天津市合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量辽宁省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量上海市合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量江苏省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量浙江省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量安徽省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量福建省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量山东省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量广东省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量四川省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量贵州省合计

图表：2009年半导体集成电路产品产量甘肃省合计

图表：2009年半导体分立器件产量全国合计

图表：2009年半导体分立器件产量北京市合计

图表：2009年半导体分立器件产量天津市合计

图表：2009年半导体分立器件产量河北省合计

图表：2009年半导体分立器件产量辽宁省合计

图表：2009年半导体分立器件产量吉林省合计

图表：2009年半导体分立器件产量黑龙江省合计

图表：2009年半导体分立器件产量上海市合计

图表：2009年半导体分立器件产量江苏省合计

图表：2009年半导体分立器件产量浙江省合计

图表：2009年半导体分立器件产量安徽省合计

图表：2009年半导体分立器件产量福建省合计

图表：2009年半导体分立器件产量江西省合计

图表：2009年半导体分立器件产量山东省合计

图表：2009年半导体分立器件产量河南省合计

图表：2009年半导体分立器件产量湖北省合计

图表：2009年半导体分立器件产量湖南省合计

图表：2009年半导体分立器件产量广东省合计

图表：2009年半导体分立器件产量广西区合计

图表：2009年半导体分立器件产量四川省合计

图表：2009年半导体分立器件产量贵州省合计

图表：2009年半导体分立器件产量陕西省合计

图表：2008年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进出口总量统计

图表：2008年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等进口分省份统计

图表：2008年经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等出口分省份统计

图表：2008年半导体集成电路产品产量全国合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量北京市合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量天津市合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量辽宁省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量上海市合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量江苏省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量浙江省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量安徽省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量福建省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量山东省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量广东省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量四川省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量贵州省合计

图表：2008年半导体集成电路产品产量甘肃省合计

图表：2008年半导体分立器件产量全国合计

图表：2008年半导体分立器件产量北京市合计

图表：2008年半导体分立器件产量天津市合计

图表：2008年半导体分立器件产量河北省合计

图表：2008年半导体分立器件产量辽宁省合计

图表：2008年半导体分立器件产量吉林省合计

图表：2008年半导体分立器件产量黑龙江省合计

图表：2008年半导体分立器件产量上海市合计

图表：2008年半导体分立器件产量江苏省合计

图表：2008年半导体分立器件产量浙江省合计

图表：2008年半导体分立器件产量安徽省合计

图表：2008年半导体分立器件产量福建省合计

图表：2008年半导体分立器件产量江西省合计

图表：2008年半导体分立器件产量山东省合计

图表：2008年半导体分立器件产量河南省合计

图表：2008年半导体分立器件产量湖北省合计

图表：2008年半导体分立器件产量湖南省合计

图表：2008年半导体分立器件产量广东省合计

图表：2008年半导体分立器件产量广西区合计

图表：2008年半导体分立器件产量四川省合计

图表：2008年半导体分立器件产量贵州省合计

图表：2008年半导体分立器件产量陕西省合计

图表：略.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/3635136351.html>